**106學年度** **3D數位電路板設計及智慧製造人才培育計畫****電路板佈局焊接競賽 活動辦法**



主辦單位：龍華科技大學 工程學院

協辦單位：龍華科技大學 電機工程系

報名截止日期：107年01月16日 星期二

競賽日期：107年01月19日 星期五 至 107年01月23日星期二

報到地點：龍華科技大學 城堡大樓 F棟2樓 積體電路實驗室(F203)

競賽地點：龍華科技大學 城堡大樓 F棟2樓 積體電路實驗室 (F203)

聯絡窗口：龍華科技大學微波通訊研究室 游育誠

聯絡地址：桃園市龜山區萬壽路一段300號

報名網址：<https://goo.gl/UK74iy>

中華民國 106 年 12 月 28日

一、活動主旨

政府積極推動「5+2」創新產業，加速產業轉型升級，其中「亞洲∙矽谷」之智慧製造，以我國「精密機械」及「電資通」厚實的產業能量為基礎，結合「智慧機械」、「虛實整合系統（CPS）」、「物聯網」、「巨量資料」及「精實管理」等技術，進而打造臺灣成為全球生產製造供應鏈關鍵地位。

二、活動目的

本活動以實作帶動思考，提昇學生未來的競爭力，讓學生能操作各種設備及培養學生獨立研究、創新思考、工程實務與解決問題能力。特辦理此活動。

三、報名資格

高中職學生

四、評審聘任及評審標準

(一) 評審聘任：由任課老師及TA擔任評審委員。

(二) 評分標準：焊接能力 (相關說明於附件一檢附)

五、競賽相關時程與地點

(一) 報名截止日期：107年01月16日 星期二

(二) 競賽日期：107年01月19日至107年01月23日

(三) 競賽報到地點：龍華科技大學 積體電路實驗室 (F203)

(四) 競賽地點：龍華科技大學 積體電路實驗室 (F203)

六、獎勵辦法

依據成績排行，第一名1名、第二名2名、第三名3名及佳作數名，頒予獎金以及獎狀以資鼓勵。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一名： | 獎金新台幣 2000元整，獎狀乙紙。 | 共1名 |
| 第二名： | 獎金新台幣 1600元整，獎狀乙紙。 | 共2名 |
| 第三名： | 獎金新台幣 1200元整，獎狀乙紙。 | 共3名 |
| 佳 作： | 獎金新台幣 600元整，獎狀乙紙。 | 共數名 |

七、聯絡資訊

聯絡人：游育誠 信箱：mp963542@gmail.com 電話：0911-036-274